

明日を切り開くシステム LSI

System LSIs Creating a Digitally Converging World

巻頭言

デジタル社会を支えるシステム LSI 技術

System LSI Technologies Sustaining Our Digitized Information Society

近年、音楽や映像あるいはデータなどのコンテンツのデジタル化により、様々な機器間でコンテンツを横断的に活用できるようになりつつあり、人々のライフスタイルにも変化が起り始めています。その結果、放送、通信、インターネットなどのサービスや機器の融合がますます加速し、いわゆるデジタルコンバージェンスが急速に進んでいます。この動向は、先進国にとどまらずグローバルに進展していますが、これらを支えているのが半導体技術の進歩であり、半導体が産業の米と言われるゆえんです。

東芝は、常に、最先端のプロセス技術、設計技術、及び応用技術を核に、メモリ、ディスクリット、及びシステムLSIを3本の柱とする垂直統合型半導体メーカーとして、時代の先駆けとなる商品群を提供し続けています。機器は複雑化し、システムを動作させるためのソフトウェア量も膨大になるため、お客さまからは、システムソリューションの提案や提供を求められます。したがって、お客さまや大学・研究機関などとも連携し、知識と知恵を集めて、ソリューションとしてまとめていくことが極めて重要になってきています。

この特集では、機器の中核を担う最新のシステムLSI、携帯電話への搭載が進むCMOS（相補型金属酸化膜半導体）イメージセンサ Dynastron™、及びLSIとメモリを組み合わせたデジタルコンテンツの保護・管理ソリューション SDconnect™、更に、大規模システムLSIの開発を効率化する社内プロジェクトR-CUBE（Reduce, Reuse, Revolution）や、いっそうの微細化を追求する最新の技術動向について紹介いたします。

当社の半導体の開発拠点であるマイクロエレクトロニクスセンターは、2008年5月に創立50周年を迎えました。過去の歴史の上に、更なる飛躍を目指して取り組んでまいります。

藤田 康彦
FUJITA Yasuhiko